

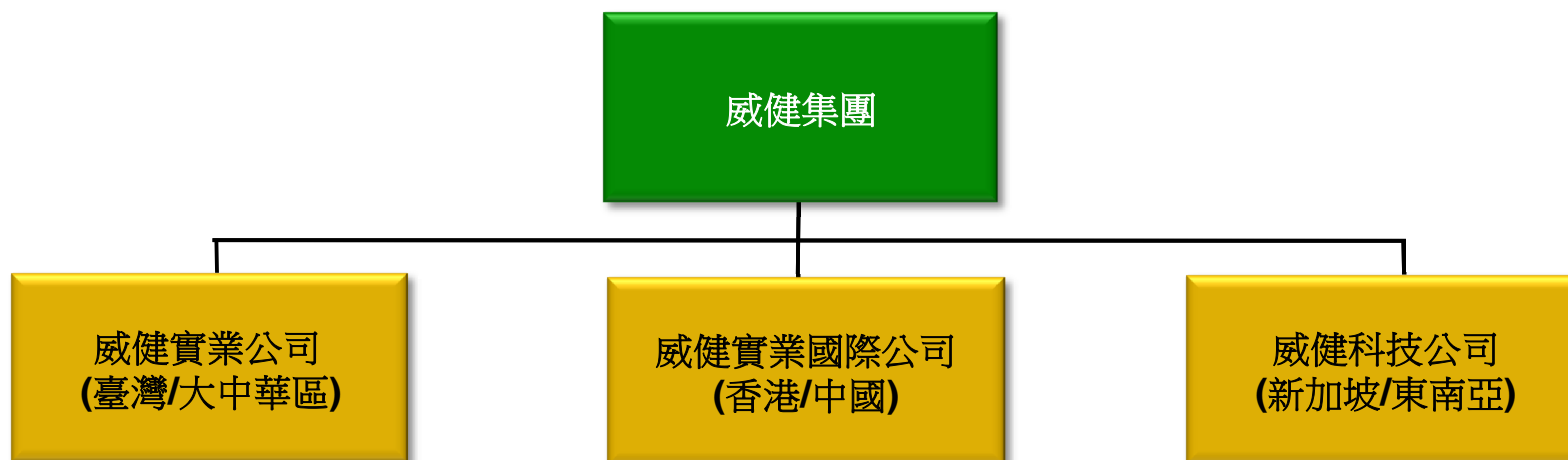


2021年第三季法人說明會

致歡迎詞	周甘淋	資深副總經理 & 發言人
公司簡介		
2021年第三季財務資訊		
2021第四季半導體市場觀察		
2021年半導體市場-初結		
問與答	紀廷芳 陳政宏 李沛霆 謝季宏	集團營運長 執行副總經理 行銷長 資深副總經理&代理發言人

- 本公司聲明對目前預期所作之前瞻性陳述，須受重大風險和不確定性因素之限制，其實際結果可能與前瞻性陳述中的含義大不相同。
- 關於可能導致實際結果發生變化的因素訊息，可以在本公司向台灣證券交易所（“TWSE”）提交的季度或年度財務報告，以及本公司不定時發布於TWSE的股市觀測站重大訊息查閱。
- 除法律規定者外，無論是由於新訊息，未來事件或其他原因，本公司不承擔更新任何前瞻性陳述的義務。
- 此外，本報告所載示之財務資料訊息係遵照國際財務報導準則(IFRSs)編制。

- 2021年前三季集團合併淨營業收入新台幣541億元(核閱數) (YoY= 26%)



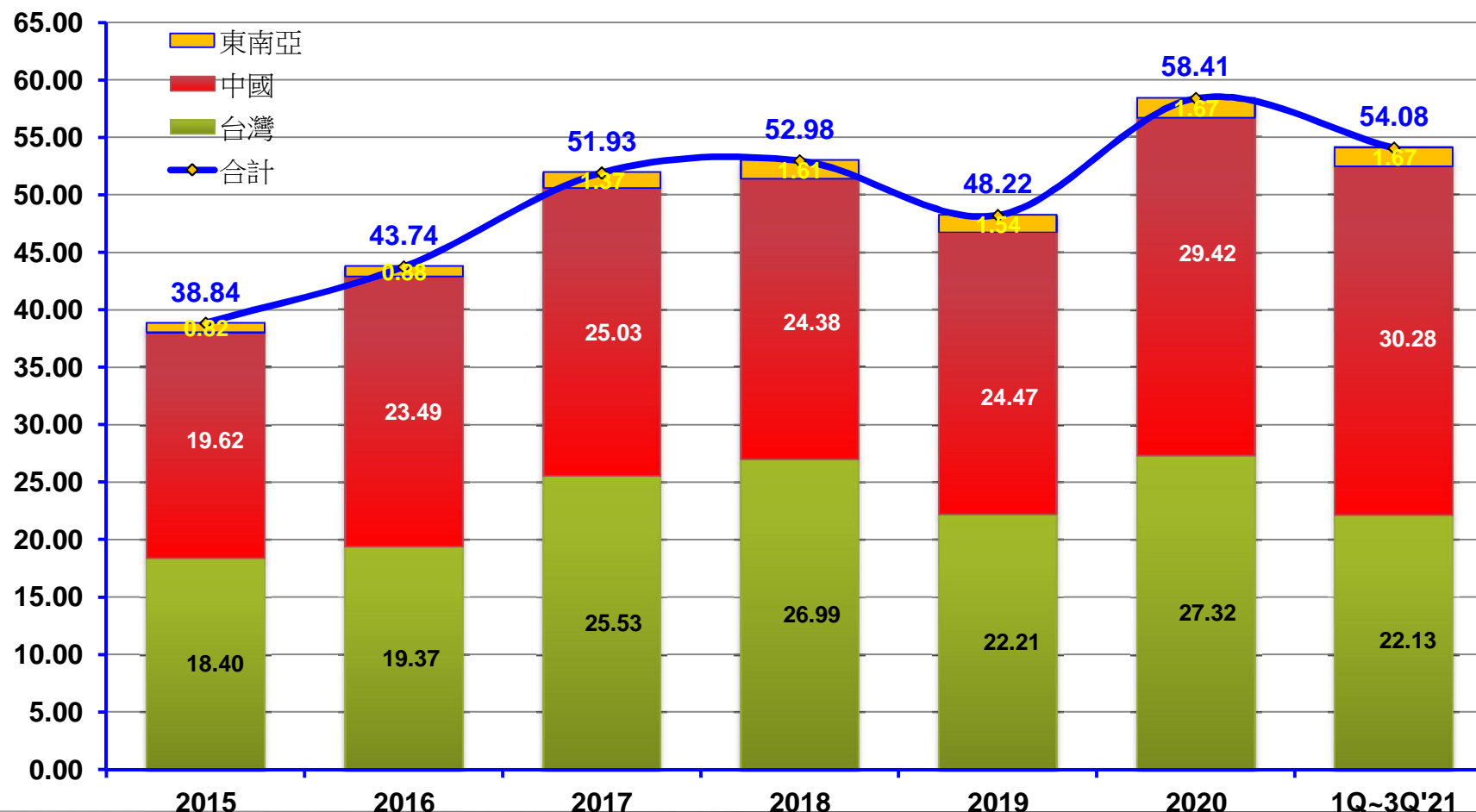
- 母公司
- 2021年前三季營業收入:新台幣221億元 (YoY= 8%)
- 100%子公司
- 2021年前三季合併營業收入:新台幣303億元 (YoY= 43%)
- 100%子公司
- 2021年前三季營業收入:新台幣17億元 (YoY= 41%)

公司簡介-營業收入趨勢(2015~2021前三季)



- 客戶分散、多元—前二十大集團客戶占比34% (2021 第一季~三季)
- 75%+ 營收來自技術支援(technical support)
- 36% 營收來自大眾市場(mass market) 客戶

NT\$ 十億元





財務資訊_合併綜合損益表



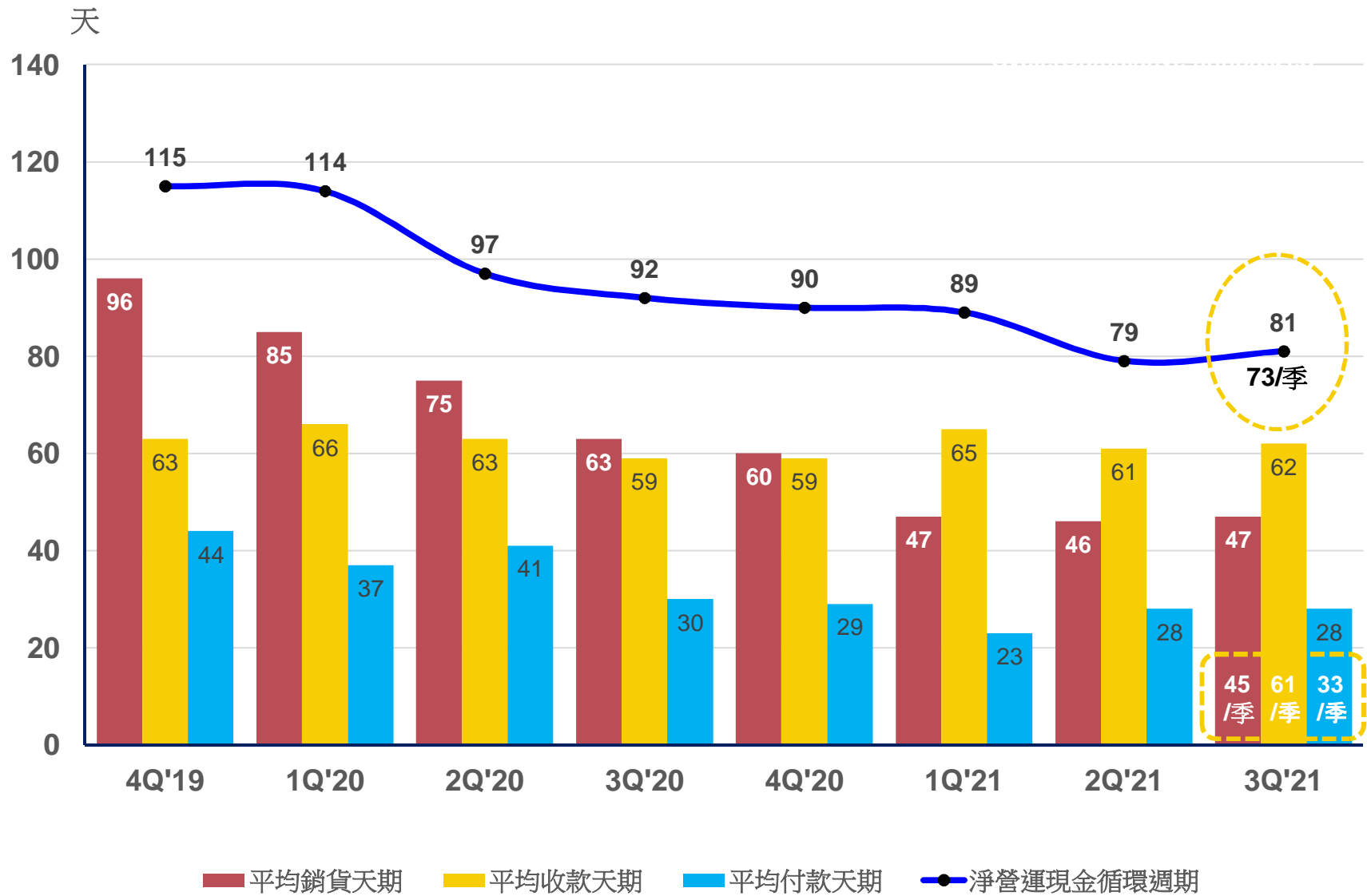
合併綜合損益表選定項目(單位:新台幣佰萬元)	2021年 第三季	2021年 前三季	2021年 第二季	2020年 前三季	2021年第 三季與上 季比較 (QoQ)	2021年前 三季與去 年同期比 較(YoY)
淨營業收入	19,581	54,085	18,680	42,824	5%	26%
營業毛利	1,525 7.79%	3,794 7.01%	1,315 7.04%	2,284 5.33%	16% +0.75百分點	66% +1.68百分點
營業費用	725	1,893	614	1,529	18%	24%
營業淨利	801 4.09%	1,900 3.51%	702 3.76%	755 1.76%	14% +0.33百分點	152% +1.75百分點
稅前淨利	777 3.97%	1,821 3.37%	663 3.55%	689 1.61%	17% +0.42百分點	164% +1.76百分點
本期淨利	532	1,261	455	529	17%	138%
基本每股盈餘(新台幣元)	1.42	3.41	1.24	1.44	15%	137%
平均匯率(美元/新台幣)	27.86	28.08	28.01	29.82	-1%	-6%

財務資訊_資產負債表及財務重要指標

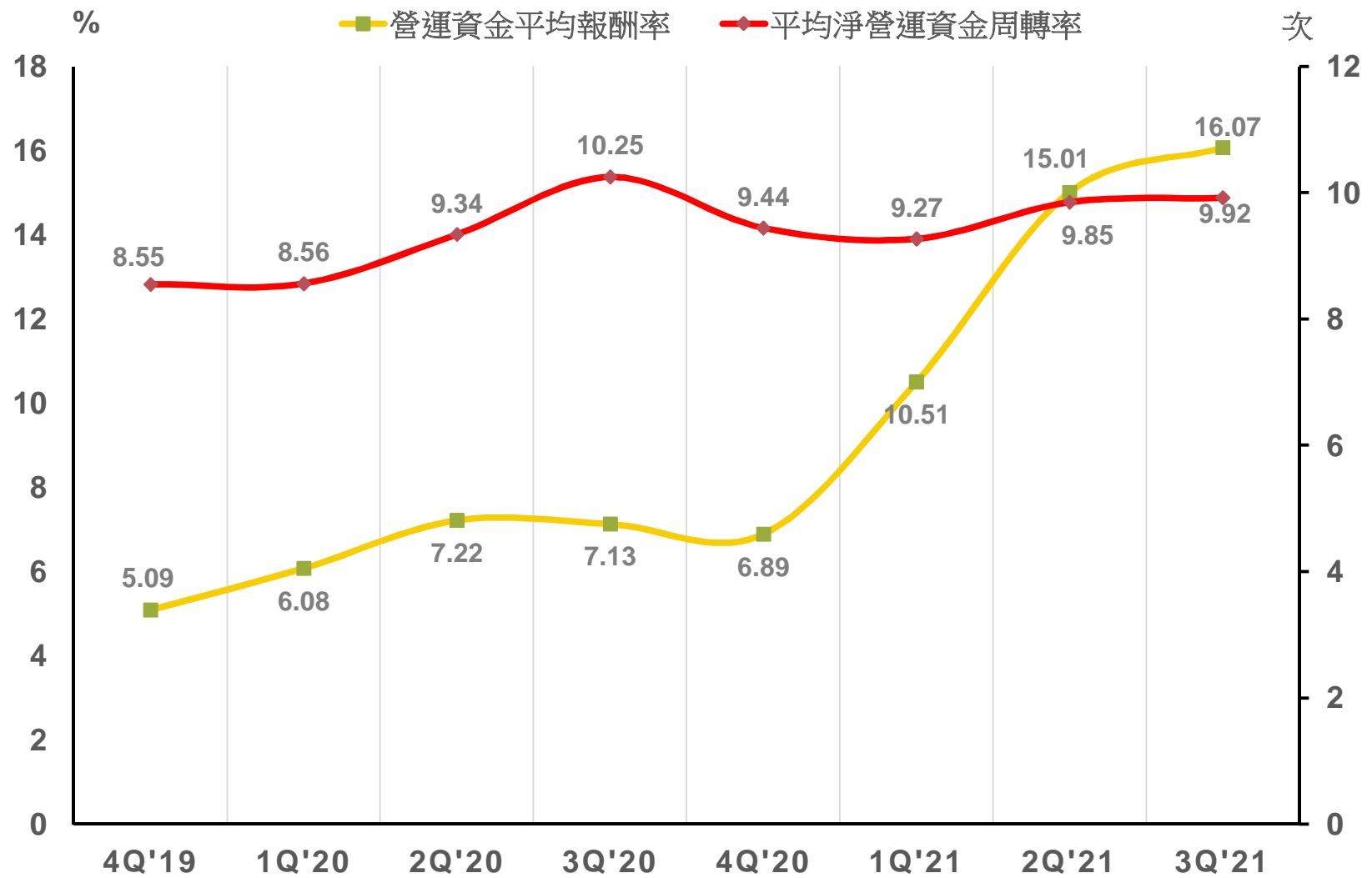


資產負債表選定科目 (單位:新臺幣佰萬元)	2021年9月底		2021年6月底		2020年12月底	
	\$	%	\$	%	\$	%
現金及約當現金	2,377	9	2,941	12	2,486	11
應收票據及帳款淨額	13,700	51	12,301	49	10,679	47
存貨淨額	9,558	35	8,303	33	7,856	34
資產總計	26,981	100	24,987	100	22,854	100
短期借款	10,022	37	8,819	35	9,745	43
應付票據及帳款	6,687	25	6,255	25	3,576	16
負債總計	19,687	73	18,689	75	16,780	73
權益總計	7,294	27	6,299	25	6,074	27
重要財務指標						
應收帳款收款天數	62		61		59	
存貨週轉天數	47		46		60	
應付帳款付款天數	28		28		29	
流動比率(倍)	1.41		1.41		1.45	
營運資金報酬率(%)	16.07		15.01		6.89	
股東權益報酬率(%)	25.16		23.58		11.91	

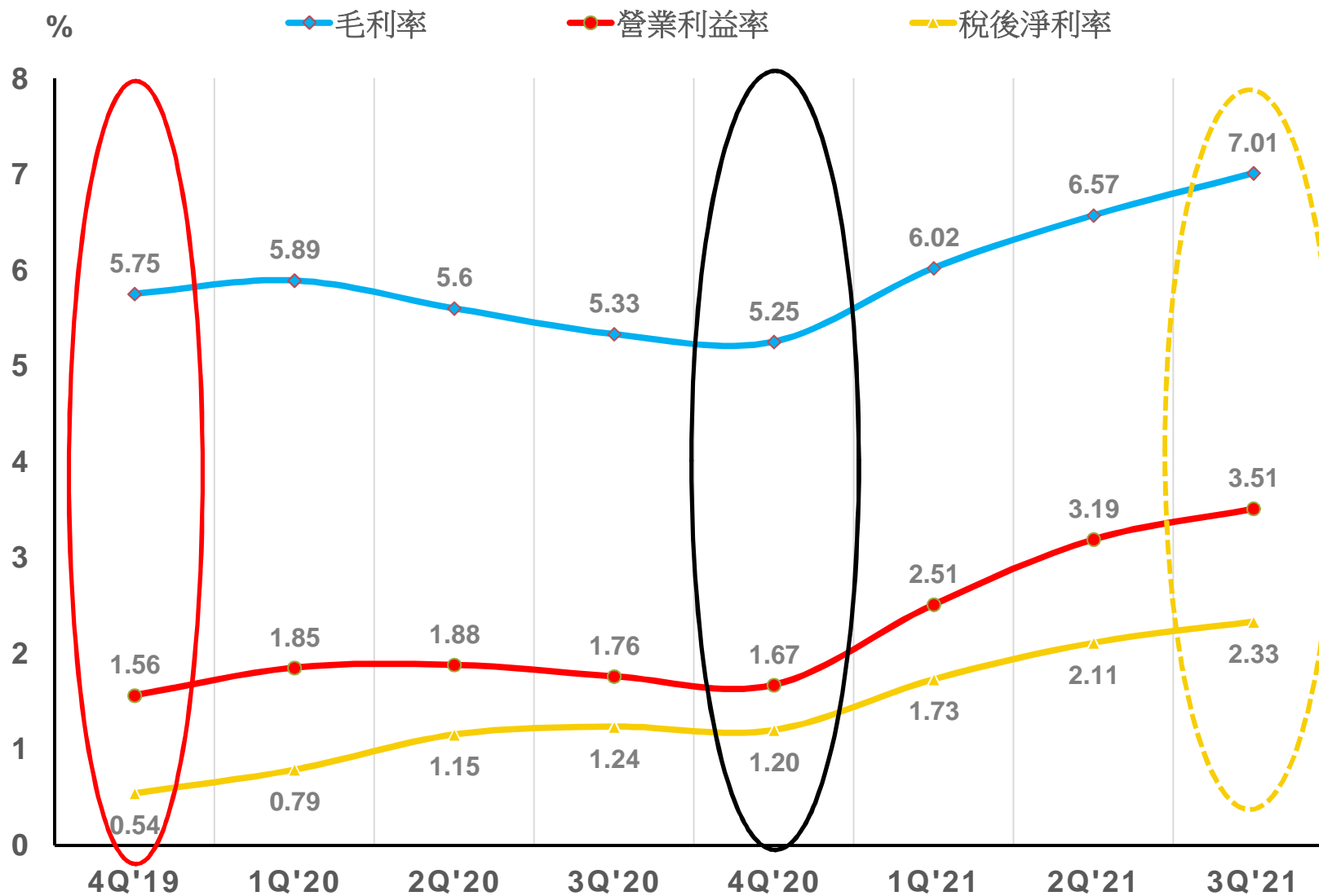
淨營運現金循環週期_年化



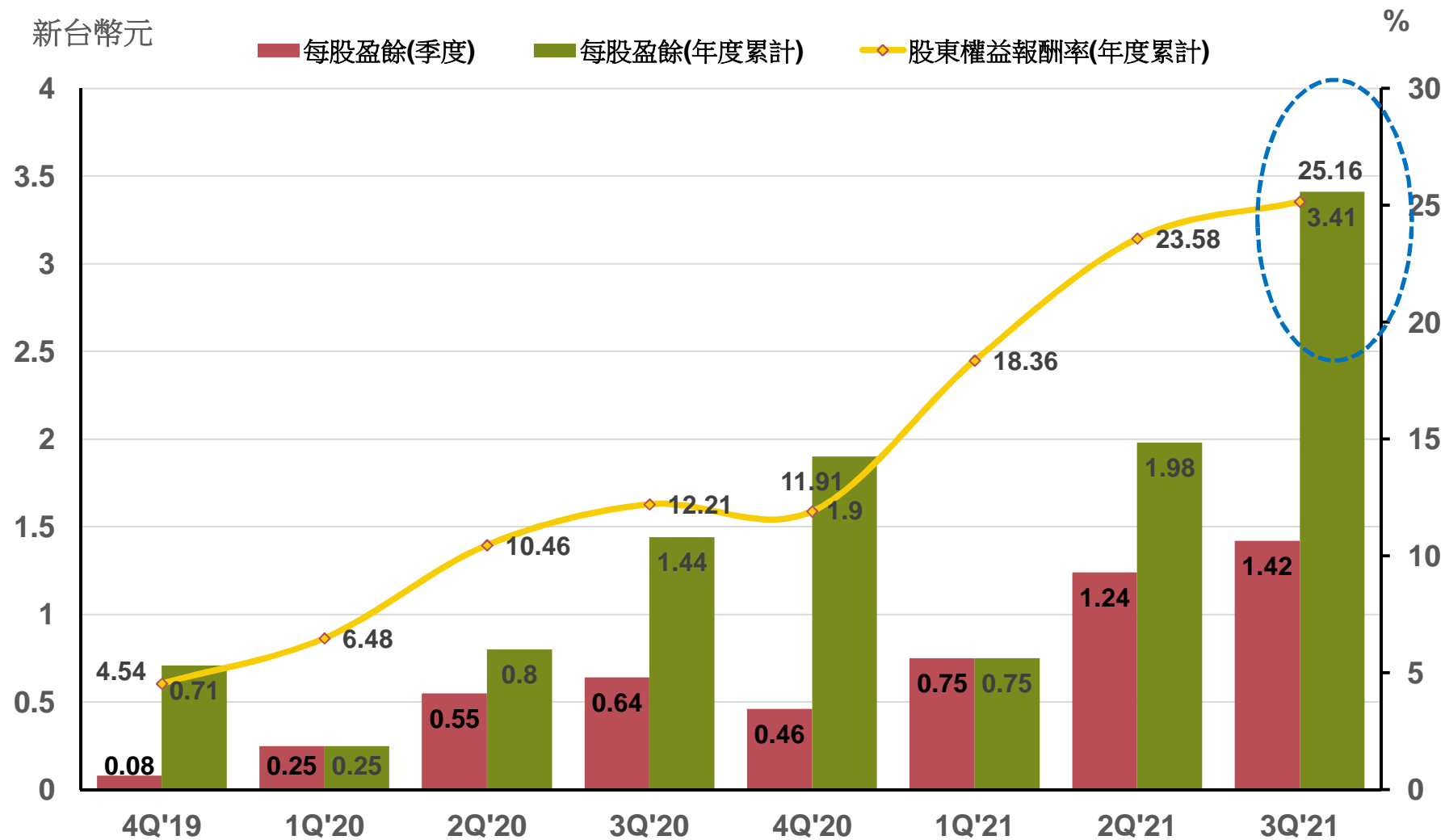
營運資金(Working Capital)效益_年化



三率(Triple Margin)_年度累積



股東權益報酬率(ROE)及每股盈餘(EPS)



- 本季需求面與供給面跟第三季類似
 - 供應鏈缺料及下游零組件庫存長短料失衡現象仍存在
 - 部分料件本季持續漲價
 - 本季市場需求依然正向可期，但可能低於第三季度
- NB (含Chromebook), Desktop 有需求放緩之跡
- 晶片交貨時間超過 20 週(長、短料平均)，第四季度沒有出現短缺緩解跡象；短料甚或超過52週
 - 5G、車用/電動車及資料中心等需求仍將持續增加
- 受限於8吋 & 12吋晶圓廠成熟製程產能限制，目前市場最缺的產品：
 - MCU, PMIC, MOSFET, DDI/TDDI, IoT/ WiFi/ BT, Audio Codec, LAN Chip, USB-Type C, etc.

2021年半導體市場-初結



現況事實	引發結果
新冠肺炎全年籠罩 肺炎疫苗不均(尤其是亞洲)	遠距數位化轉型及科技化應用帶動半導體需求拉升
斷鏈(德州冰風暴、日本Renesas火災、 物流海空運運能不足等)	缺料、OEMs/ODMs拉高存貨水準(>12週)、價漲、產業鏈出現”長鞭效應”
晶圓產能分配(先進製程與成熟製程、資本支出投資)	短期內跟不上需求，仍存缺料(~2022年上半年)，2023年可以供需平衡，甚至部分領域供給過剩
IC Insights	2021產值(~US\$570 Billion), YoY 24%
WSTS	2021產值(US\$ 551 Billion), YoY 25.1% 2022 US\$606 Billion, YoY 10.1%
Weikeng Group	2021 Jan~Oct營收, YoY 24%

Large, 3D, green letters with black outlines spelling 'Q & A'. The letters are positioned in the center of the white page, casting soft shadows below them.

謝謝您



<https://www.Weikeng.com.tw/conference.php>